

2018年12月13日

ヘンケルジャパン、車載電装品向けトータルソリューション展示 ～第11回国際カーエレクトロニクス技術展 出展～

ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社(本社:東京都品川区 社長:金井 博之)のエレクトロニクス事業部は、「第11回国際カーエレクトロニクス技術展」(会期:2019年1月16日～18日 会場:東京ビッグサイト)に出展します。ヘンケルジャパンブースでは、センサー/カメラなどの最新の電装品の要求仕様に対応した、トータルソリューションをご紹介します。

【ヘンケルジャパン 主な展示製品】

熱対策材料

■熱伝導性ギャップフィラー(液状)

ディスペンサーで自動塗布可能。豊富な車載実績。放熱が要求される車載電子部品全般、振動が加わる箇所に。Bergquist 製品。

■熱伝導性接着剤(液状)

幅広い温度下で機械的・化学的安定性に優れる。パワーデバイスと放熱板の接着、プリント基板と筐体の直接接着に。Bergquist 製品。

接着剤

■はんだ代替導電性接着剤

めっき対応、低弾性など。豊富な車載実績。バッテリーなどのプリント基板、同時焼成セラミック回路の導電性電極に。

■組み立て用接着剤

UV硬化型、ウレタン系ホットメルト、T_g高信頼性タイプ。カメラモジュールなどに。

■高熱伝導ダイアタッチペースト

導電性/銀ペースト、焼結銀、セミンタリングなど幅広いダイアタッチ材。各種はんだ代替。パワー半導体、小型～大型LEDチップに対応。

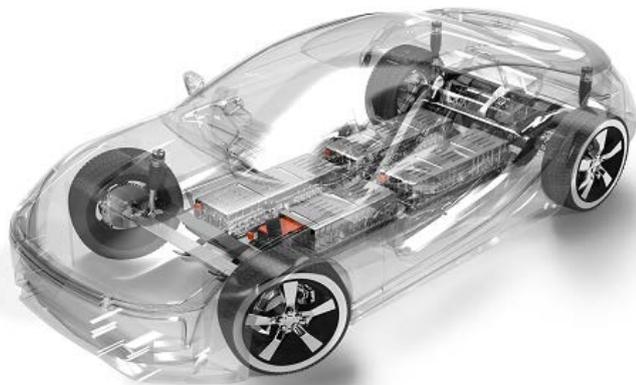
保護・封止材

■PCB保護

環境と熱サイクルからPCBを強かに保護。車載用センサー、ホール素子センサー、回路基板の保護、スイッチ類、バッテリーのシールに。

■アンダーフィル

均一でボイド隙間のないアンダーフィル層を形成。はんだ接合部の応力を分散。ECU、各種センサーモジュールのCSP、BGAアンダーフィル及びQFP、QFN、チップ部品などの補強に。



LOCTITE BONDERITE TECHNOMELT TEROSON AQUENCE Ceresit

第11回 国際カーエレクトロニクス技術展
(カーエレJAPAN)

【展示会概要】

名称：第11回国際カーエレクトロニクス技術展 <https://www.car-ele.jp/ja-jp.html>

会期：2019年1月16日(水)～18日(金) 10:00～18:00 (最終日は17:00終了)

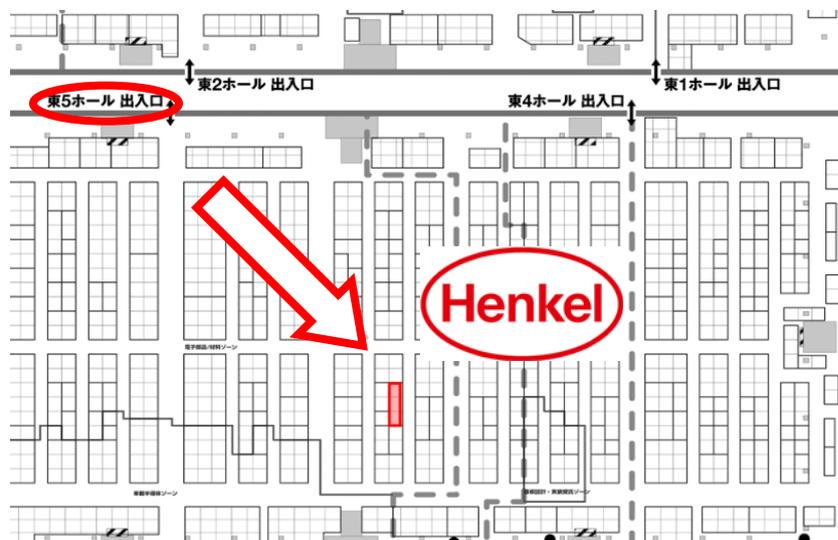
会場：東京ビッグサイト

主催：リードエグジビション ジャパン株式会社

概要：カーエレクトロニクスの進化を支える半導体・電子部材、ソフトウェア、テスト技術など一堂に出展する本分野世界最大の専門展。

【ヘンケルジャパンプース番号】：E39-32 (東5ホール 電子部品/材料ゾーン)

<https://www.car-ele.jp/ja-jp/visit/map.html>



ヘンケルについて

ヘンケルはバランスのよい、多角的なポートフォリオを備え、産業および一般消費者向け事業をグローバルに展開しています。優れたブランドとイノベーション、テクノロジーを誇るヘンケルは、アドヒーズブテクノロジーズ(接着技術)、ビューティーケア、ランドリー&ホームケアの3分野において、グローバルリーダーとしての地位を維持しています。1876年に創立し、140年以上に及ぶ成功の歴史があるヘンケルは、ドイツのデュッセルドルフに本社を置き、世界に約53,000名の社員を擁しています。サステナビリティの分野をリードする存在として評価されるヘンケルは、多くの国際的指標やランキングでトップの地位を維持しています。2017年の売上高は200億ユーロ、営業利益はおよそ35億ユーロに上ります。ヘンケルの優先株はドイツ株式指数DAXのリストに入っております。さらなる情報はこちら www.henkel.com をご覧ください。

ヘンケルジャパンホームページ: <http://www.henkel.co.jp>

ヘンケルジャパンフェイスブックページ: <http://www.facebook.com/HenkelJapan>

— 本件に関するお問合せ先 —
ヘンケルジャパン株式会社 接着技術事業部門
マーケティング部 担当: 小林 由紀
TEL: 045-758-1869 e-mail: yuki.kobayashi@henkel.com